



廣閎科技股份有限公司

節能應用IC與系統設計整合方案提供者

法人說明會

主講人：林明璋博士

2025/3/21

免責聲明

- 本簡報及同時發佈之相關訊息內含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊，其中包括營運展望、財務狀況以及業務預測等內容。
- 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異。其原因可能來自於各種因素，包括但不限於市場需求、價格波動、競爭情勢、國際經濟狀況、供應鏈、匯率波動以及其他本公司所不能掌控的風險等因素。
- 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。

簡報大綱

- 經營績效
- 廣閔主要產品及近期成長趨勢
- 2025-2026未來進程規劃

廣閎科技股份有限公司

inergy Technology Inc.

成 立 日 期 | 2007年11月
資 本 額 | NTD 457,200仟元
董事長兼總經理 | 林明璋 博士

企業總部
新竹縣竹北市台元二街8號8樓之3

深圳辦公室
深圳市福田區深南大道6021號A幢1505-1508室

廣閎科技是專注於節能應用之IC設計公司

核心產品：功率金氧半場效電晶體、無刷直流馬達驅動控制
模組、數位類比可程式化SoC散熱風扇驅動IC，提供低碳、
低耗能的高能源效率產品，從IC到電機/電池/電源管理創新
系統設計方案

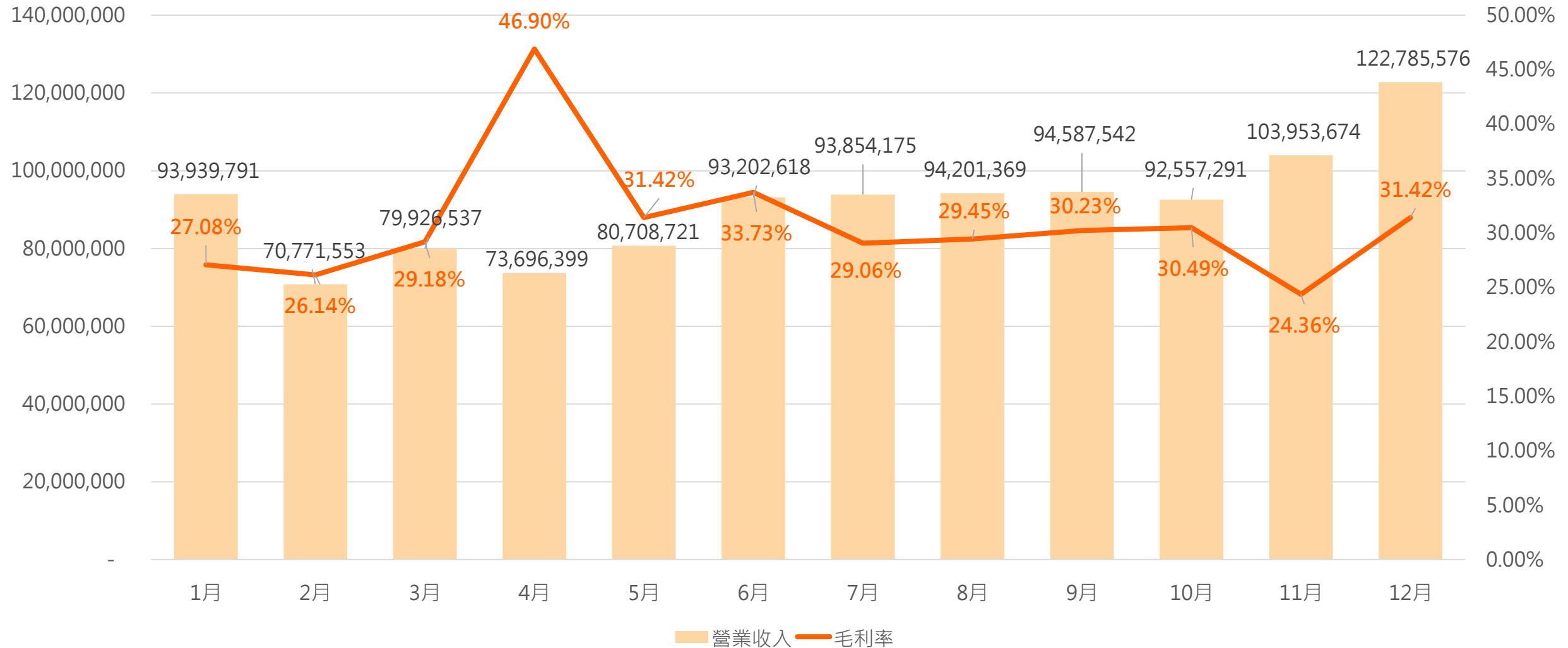
成立於2007年，2022年在財團法人證券櫃檯買賣中心
(Taipei Exchange, TPEx)正式上櫃交易
股票代碼 6693.TWO.



經營績效

經營績效

2024每月營收與毛利率



經營績效

合併綜合損益表 (2023-2024)

	2024	2023	YoY
營業收入	1,094,185	960,374	14%
營業毛利	334,359	177,016	89%
營業費用	213,525	156,313	37%
營業淨利	120,834	20,703	484%
營業外收(支)	69,806	3,295	2019%
稅前淨利	190,640	23,998	694%
所得稅費用	38,223	7,690	397%
歸屬於母公司之淨利	152,417	16,308	835%
每股盈餘(NTD)	3.33	0.36	825%

重要財務比率	2024	2023
毛利率	31%	18%
營業淨利率	11%	2%
淨利率	14%	2%

單位：新台幣千元

經營績效

合併資產負債表 (2023-2024)

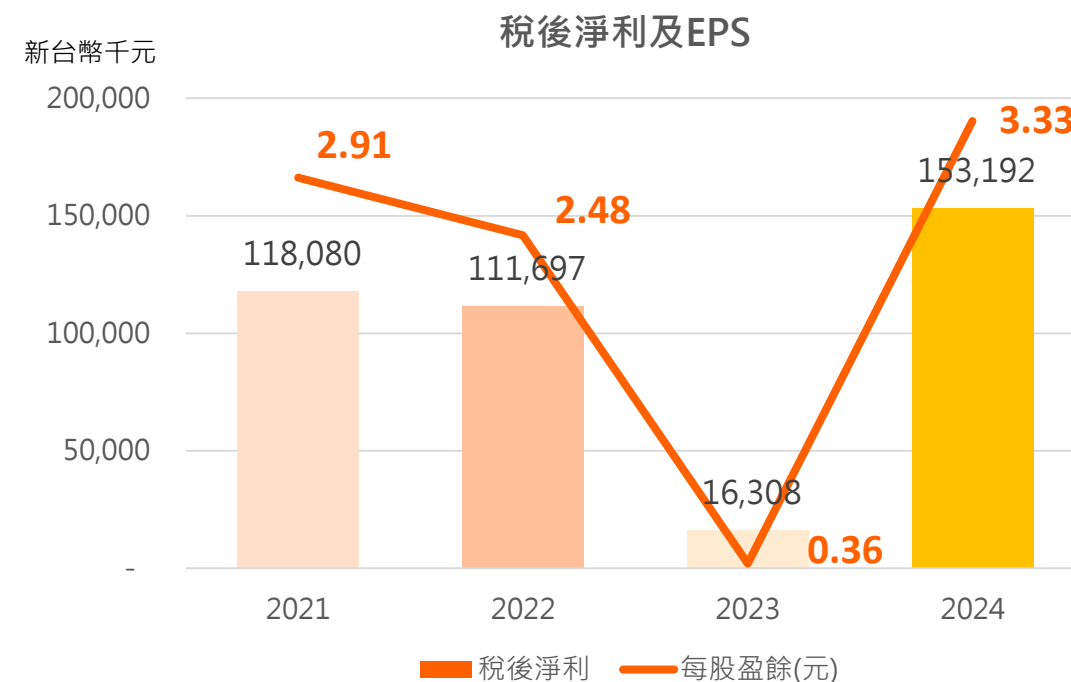
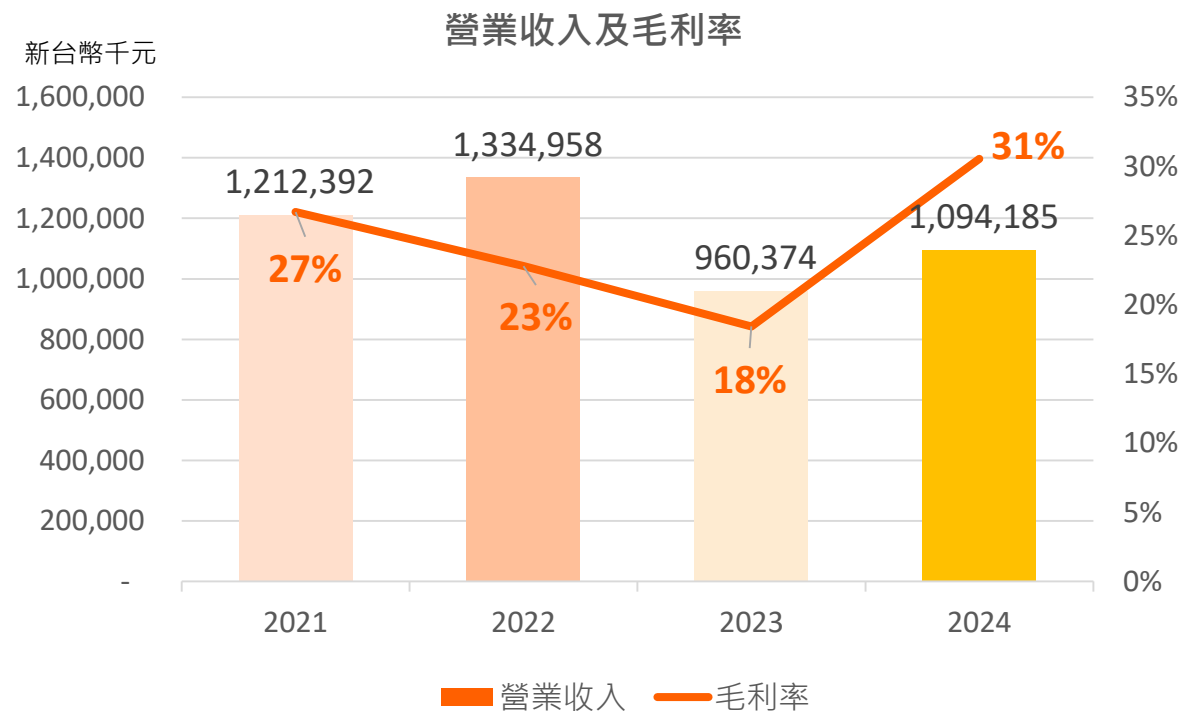
	2024	2023	YoY
資產總額	1,805,954	1,524,904	18%
現金及約當現金	759,618	546,741	39%
應收票據/帳款	207,796	132,802	56%
存貨	280,991	201,607	39%
不動產廠房及設備	320,740	318,743	1%
存出保證金/其他金融資產	152,316	224,407	-32%
負債總額	597,524	426,094	40%
短期借款	74,516	-	
一年內到期長期借款	14,780	14,528	2%
應付票據/帳款	198,354	88,623	124%
應付股利	91,440	45,720	100%
長期借款	165,682	180,456	-8%
存入保證金	35,000	70,000	-50%
股東權益總額	1,208,430	1,098,810	10%

重要財務指標	2024	2023
應收帳款週轉天數	55.64	53.67
存貨週轉天數	164.41	195.18
應付帳款週轉天數	68.93	71.89
股東權益報酬率(%)	13.21	1.43
資產報酬率(%)	9.38	1.17
負債比(%)	33.09	27.94

單位：新台幣千元

經營績效

2021-2024 營收/毛利率/稅後淨利/EPS



項目/年度	2021年	2022年	2023年	2024年
營業收入淨額(千元)	1,212,392	1,334,958	960,374	1,094,185
營業毛利(千元)	323,710	304,260	177,016	334,359
毛利率(%)	27%	23%	18%	31%
稅後淨利(千元)	118,080	111,697	16,308	153,192
每股盈餘(元)	2.91	2.48	0.36	3.33

經營績效-高配息的股利政策

年度	每股盈餘 (NT\$)	股利 (NT\$)	現金股利 (NT\$)	資本公積 (NT\$)	配息率
2024	3.33	2	2		60%
2023	0.36	1	0.46	0.54	277%
2022	2.48	2	2		81%
2021	2.91	2.2222	2.2222		76%
2020	0.72	0.1969	0.1969		27%

連 5 年發放股利，合計 7.419 元。

廣閱主要產品線及近期發展趨勢

核心價值與競爭優勢



專注**節能技術**領域，致力於
高性能功率元件、**高效率**、
高可靠BLDC電機與**散熱扇**
 驅動技術，整合關鍵技術，
 提供**高效**、**智能系統方案**

主要產品

Power MOSFET

中低壓Power MOSFET



低導通電阻RDS(ON)、較高電流載流能力、高效能封裝

Fan & Motor

All-in-One風扇驅動IC、單相/三相BLDC馬達驅動IC



高整合度IC、自有馬達驅動控制技術

主要應用



功率金氧半場效電晶體應用

- 高效能低封裝阻抗設計、低電容SGT MOS，適用於各式電機驅動與電源相關應用。

成長力道 



電動工具/電動載具

100A-300A高電流，適用於電動工具/電動載具等高電流應用。

成長力道持平



節能電機驅動

高效能低電磁干擾，適用於電機驅動的節能設施。

成長力道 



PC/NB電源系統

高ESD小訊號MOS元件，具備高能源效率，適用於PC與NB電源系統。

成長力道 



鋰電池BMS

高可靠度與高能源效率，適用於鋰電池相關設備應用。

無刷直流馬達驅動控制模組應用

- 自有直流馬達驅動控制技術，採用易於使用的韌體平台，客戶可輕鬆依據不同特性進行參數調整。
- 無刷直流馬達驅動控制技術獲得知名大廠認證與量產實績。

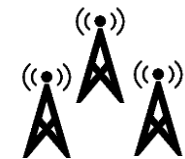


商 用

成長力道



伺服器散熱系統
氣冷/水冷

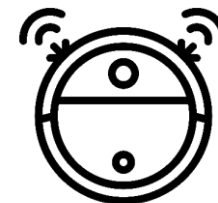


4G/5G基地台散熱系統

家 電



冰箱



掃地機器人



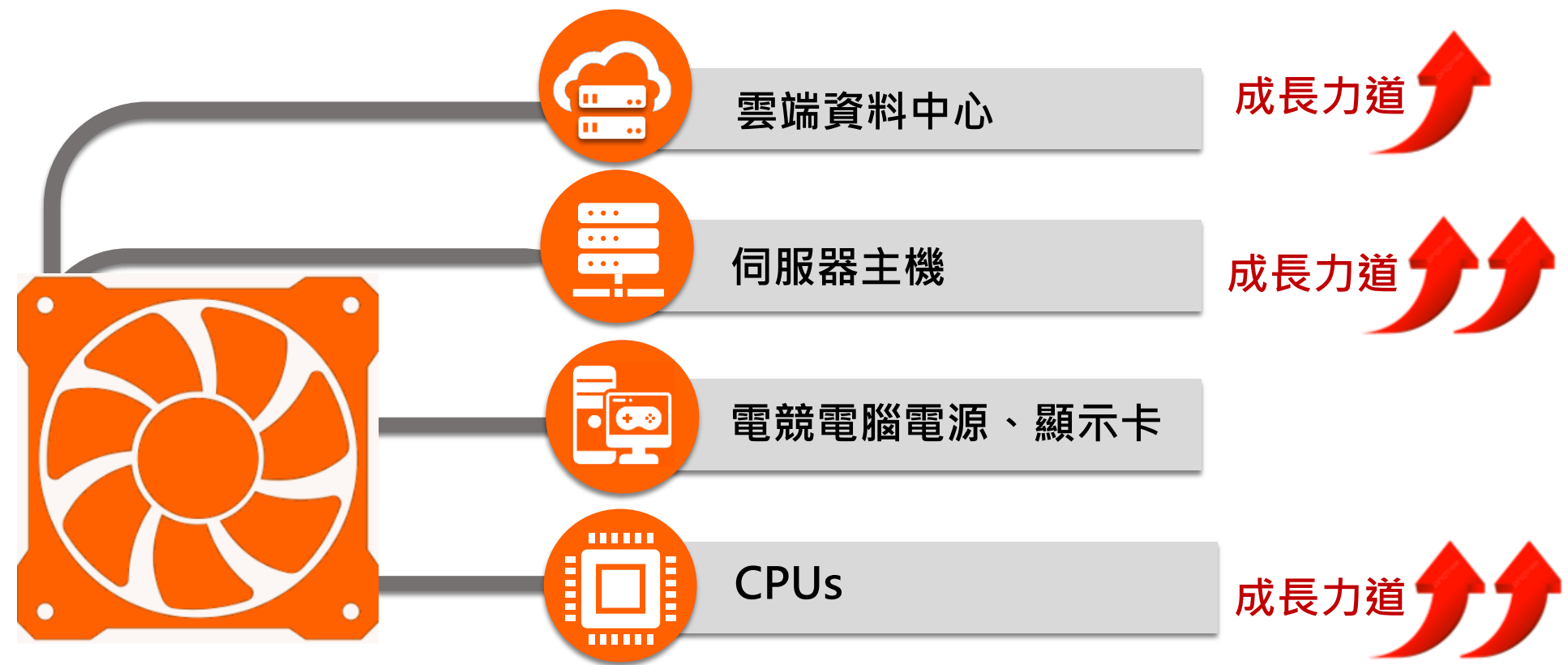
吸塵器



吊扇

數位類比可程式化SoC散熱風扇驅動IC應用

■ 數位類比可程式化SoC散熱風扇驅動IC，提供節能高效的散熱方案。



2024營收相較於2023，成長30%

2025-2026進程規劃

業務拓展 日本、韓國、中國、越南、印度等市場推廣



廣閱科技總部與研發中心

2025-2026未來進程

功率金氧半場效
電晶體

持續強化MOSFET產品線：高能源轉換效率的中壓MOSFET，適用於資料中心與電動二輪車的大電流產品。

無刷直流馬達
驅動控制模組

馬達風扇導入AI伺服器散熱供應鏈，進入量產。
FOC散熱方案，符合市場精準控制並滿足高階伺服器風扇需求，與客戶共同開發下一代的散熱方案。

數位類比
可程式化SoC
散熱風扇驅動IC

CPU運算主晶片兩大客戶，用於國內外散熱系統商已進入量產。
家電需求補助帶動舊換新，預期有小幅成長。
第三代產品開發中。

研發實力提升
持續拓展業務區域

新人才加入，研發實力提升，開發更多節能應用產品。
持續擴展業務地區，導入印度的電動二輪車市場。

Q&A

Thank You